

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-075

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称“浙江金瑞泓”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司本次为浙江金瑞泓提供的担保额度为人民币 30,000 万元，截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 78,733.33 万元。
- **本次担保无反担保**
- **本公司不存在逾期对外担保**

一、担保情况概述

（一）担保事项说明

为满足生产经营对资金的需求，浙江金瑞泓向交通银行股份有限公司宁波分行申请借款 30,000 万元，公司近日与交通银行股份有限公司宁波分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签署保证合同提供连带责任保证，担保金额 30,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次担保无反担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

浙江金瑞泓科技股份有限公司，注册地点为浙江省宁波市、法定代表人为李刚，统一社会信用代码：913302007204926720。经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路设计；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币 24,236 万元，本公司直接持有其 88.49% 的股权，另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.04% 的股权，本公司合计持有其 88.53% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江金瑞泓经审计的资产总额为 363,177.79 万元，其中流动资产 276,479.96 万元、非流动资产 86,697.83 万元，负债总额为 149,591.93 万元，其中流动负债 128,136.87 万元、非流动负债 21,455.05 万元，净资产总额为 213,585.86 万元。2023 年度，浙江金瑞泓经审计的营业收入为 155,407.89 万元，净利润为 18,789.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为 7,346.58 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，浙江金瑞泓未经审计的资产总额为 359,741.93 万元，其中流动资产 275,945.48 万元、非流动资产 83,796.45 万元，负债总额为 143,692.45 万元，其中流动负债 122,262.79 万元、非流动负债 21,429.66 万元，净资产总额为 216,049.48 万元。2024 年 1-3 月，浙江金瑞泓未经审计的营业收入为 41,494.31 万元，净利润为 2,463.62 万元，经营活动产生的现金流量净额为 11,118.55 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的保证合同，其主要内容如下：

保证人：杭州立昂微电子股份有限公司

贷款人：交通银行股份有限公司宁波分行

- 1、担保额度：30,000 万元；
- 2、保证方式：连带责任保证；
- 3、保证责任期间：履行债务期届满之日起 3 年。

四、担保的必要性与合理性

本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划，被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，且公司对被担保子公司具有控制权，能够对其经营进行有效管理，担保风险整体可控，不会对

公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其他少数股东持股比例较小且不参与公司经营管理，故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保系公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第四届董事会第三十二次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内控股子公司，本次担保有助于子公司解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司控股子公司，能够对其经营进行有效管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 246,208.26 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 246,208.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.88%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日